

研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム

産学共同(育成型) 事後評価結果

体系的課題番号	: JPMJTR20RA
採 択 年 度	: 2020 年度
分 野	: ICT・電子デバイス、ものづくり分野
研究開発課題名	: 半導体ダイヤモンドウエハの革新的製造技術の開発
プロジェクトリーダー 研究責任者	: 徳田 規夫(金沢大学)

評価結果の総合所見

本課題は、低コストで量産化が可能な半導体ダイヤモンドウエハの実現に向け、ダイヤモンドのインゴット製造、スライス加工、平坦化に関する技術の開発を目指すものである。

概ね目標を達成し、企業との共同研究も進んでおり、次の研究開発フェーズ移行に必要な成果が得られた。

技術的には確実に進んだものの、社会実装につなげるためには、社会情勢を踏まえた目標設定が重要となる。多くの企業の注目を集める中、今後の研究の方向性についての議論が進むことを期待する。

以上